华创证券有限责任公司

关于

池州华宇电子科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

华创证券有限责任公司
HUA CHUANG SECURITIES CO., LTD.

贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号

二〇二五年六月

声明

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受池州华宇电子科技股份有限公司（以下简称“华宇电子”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，就本次发行出具本发行保荐书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）等主管部门制定的有关法律、法规及业务规则，保荐机构及指定的保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照相关法律法规、业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《池州华宇电子科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次负责推荐的保荐机构

本次负责推荐的保荐机构为华创证券有限责任公司。

二、保荐代表人基本情况

华创证券有限责任公司指定孙翊斌和黄永圣千为本次华宇电子向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐代表人。

孙翊斌：保荐代表人，现任华创证券投资银行一部执行总经理，具备非执业注册会计师、非执业注册税务师资格，工商管理硕士。2006年起从事与投资银行业务相关的上市公司及IPO审计工作，担任过山航B、闽灿坤B、奥特迅、深国商、广聚能源、华谊嘉信年报审计会计师以及华谊嘉信、兆日科技IPO申报会计师；2012年3月起从事投资银行业务，分别参加了湖南空港实业股份有限公司、长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票申报工作，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份购买资产、浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股份、气派科技科创板IPO等投资银行业务项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

黄永圣千：保荐代表人，现任华创证券投资银行一部副总监，具有多年投资银行业务经验，曾参与或负责气派科技科创板IPO上市、华宇电子拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市、提牛科技拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

三、项目协办人及其他项目组成员

（一）项目协办人

华创证券有限责任公司指定危唯为本次发行的项目协办人，其保荐业务执行情况如下：

危唯：现任华创证券投资银行部副总监，硕士学历，注册会计师，具有法律职业资格。曾供职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），曾参与华宇电子拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市、提牛科技拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市、捷捷微电发行股份购买资产等项目，具备丰富的财务理论及实践经验。

（二）项目组其他成员

项目组的其他成员有万静雯、楼奕颖、王兆琛、黎颖、荆达、李家浩。

四、发行人基本情况

（一）发行人情况概览

公司名称	池州华宇电子科技股份有限公司
英文名称	Chizhou Hisemi Electronics Technology Co., Ltd.
证券简称	华宇电子
证券代码	874578
统一社会信用代码	91341700394369432D
注册资本	6,344.8097 万元
法定代表人	彭勇
有限公司成立日期	2014 年 10 月 20 日
股份公司成立日期	2020 年 12 月 30 日
挂牌日期	2024 年 10 月 23 日
目前所属层级	创新层
住所	安徽省池州市经济技术开发区凤凰路 106 号
邮政编码	247099
联系电话	86-566-2818107
传真	86-566-2818016
电子邮箱	mengtao@hisemi.com.cn
公司网址	http://www.hisemi.com.cn/
信息披露和投资者关系	负责部门：证券法律部
	负责人：孟涛
	联系电话：86-566-2818107
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
主营业务	公司主要从事集成电路封装和测试业务，主营业务包括集成电路

	封装、晶圆测试、芯片成品测试
本次证券发行类型	向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

（二）本次发行前后股权结构

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
有条件限售股份	51,138,000	80.60	51,138,000	60.45
无条件限售股份	12,310,097	19.40	33,460,097	39.55
合计	**63,448,097**	**100.00**	**84,598,097**	**100.00**

（三）发行人前十名股东情况

本次发行前，公司前十名股东合计持有公司5,908.17万股股份，持股比例合计为93.12%，具体情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	股权比例（%）	股份性质
1	彭勇	21,591,562	34.03	境内自然人
2	高莲花	16,377,188	25.81	境内自然人
3	赵勇	8,500,000	13.40	境内自然人
4	黄山毅达	3,550,772	5.60	境内合伙企业
5	高新华	2,531,250	3.99	境内自然人
6	华宇芯管理	2,138,000	3.37	境内合伙企业
7	芜湖毅达	1,183,590	1.87	境内合伙企业
8	苏州涌宸	1,104,679	1.74	境内合伙企业
9	上海涌月	1,104,679	1.74	境内合伙企业
10	李明正	1,000,000	1.58	境内自然人
合计		**59,081,720**	**93.12**	

（四）发行人报告期内发行融资情况

报告期内，公司不存在股票发行融资情况。

（五）发行人报告期内现金分红及净资产变化情况

1、发行人报告期内现金分红情况

2024年12月3日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》，以截至2024年9月30日公司总股本63,448,097股为基础，向全体股东每10股分配现金红利人民币5元（含税），共计派发现金红利31,724,048.50元。

2、发行人报告期内净资产变化情况

序号	截止日	归属于挂牌公司股东的净资产（万元）
1	2022年12月31日	59,600.83
2	2023年12月31日	64,195.34
3	2024年12月31日	66,690.38

（六）最近三年主要财务数据及财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产合计	36,502.24	33,608.61	32,107.88
非流动资产合计	136,247.61	108,246.84	79,788.34
资产总计	172,749.85	141,855.45	111,896.22
流动负债合计	65,322.64	61,724.18	37,341.55
非流动负债合计	40,736.82	15,935.93	14,953.84
负债合计	106,059.46	77,660.11	52,295.39
归属于母公司所有者净资产	66,690.38	64,195.34	59,600.83
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	66,690.38	64,195.34	59,600.83

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	68,288.55	57,812.59	55,759.44
营业利润	6,041.05	4,381.80	7,914.58
利润总额	5,989.76	4,316.68	8,584.91
净利润	5,667.45	4,202.05	8,596.35
归属于母公司所有者的净利润	5,667.45	4,202.05	8,596.35

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	16,674.43	11,528.37	12,771.34
投资活动产生的现金流量净额	-38,133.50	-17,338.05	-14,315.72
筹资活动产生的现金流量净额	26,711.88	4,496.41	4,025.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响	33.95	83.96	106.79
现金及现金等价物净增加额	5,286.75	-1,229.31	2,587.80

4、主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	68,288.55	57,812.59	55,759.44
毛利率（%）	24.57	25.40	30.81
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	5,519.43	4,145.26	6,018.11
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公司所有者的净利润计算）	8.46	6.79	15.77
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.23	6.70	11.04
基本每股收益（元/股）	0.89	0.66	1.35
稀释每股收益（元/股）	0.89	0.66	1.35
应收账款周转率（次）	5.60	4.86	6.15
存货周转率（次）	7.71	6.82	5.45
经营活动产生的现金流量净额	16,674.43	11,528.37	12,771.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.63	1.82	2.01
研发投入占营业收入的比例（%）	5.93	6.66	5.96
项目	**2024 年 12 月 31 日**	**2023 年 12 月 31 日**	**2022 年 12 月 31 日**
总资产	172,749.85	141,855.45	111,896.22
总负债	106,059.46	77,660.11	52,295.39
归属于母公司所有者的净资产	66,690.38	64,195.34	59,600.83
应收账款	10,421.09	12,499.93	9,891.06
预付款项	190.97	136.30	225.35
存货	7,130.24	5,221.06	6,786.36
应付账款	29,977.90	33,563.43	15,374.55
归属于挂牌公司股东的每股净资产	10.51	10.12	9.39
资产负债率（%）	61.39	54.75	46.74
流动比率（倍）	0.56	0.54	0.86
速动比率（倍）	0.44	0.44	0.63

上述财务指标计算公式如下：

1、每股净资产=期末所有者权益÷期末股本数；

2、归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司股东的所有者权益÷期末股

本数；

3、资产负债率=期末合并负债总额/期末合并资产总额×100%；

4、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%；

5、息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋折旧+摊销；

6、净资产收益率、每股收益参照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算；

7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本数；

8、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

9、存货周转率=营业成本/存货平均余额；

10、流动比率=期末流动资产/期末流动负债；

11、速动比率=期末速动资产/期末流动负债=（流动资产-预付款项-存货-持有待售资产-其他流动资产）/ 期末流动负债。

五、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明

截至本发行保荐书签署日，发行人与保荐机构之间不存在下列情形：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方的股份，在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间存在互相提供担保或融资的情形；

（五）保荐机构与发行人之间存在其他关联关系的情形。

六、保荐机构内部审核程序及内核意见

（一）内部审核程序

在向中国证监会、北京证券交易所推荐本项目之前，保荐机构已经通过项目立项审批、问核程序、内核部门审核和内核会议审核等内部控制程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核查的职责。

1、项目立项审批

项目组经过项目立项前的初步尽职调查工作，于2025年3月28日向股权债权产品管理部提交了立项申请。股权债权产品管理部对项目组提交的立项申请材料进行了初步审核同意后，于2025年4月9日提请立项委员会进行立项审批。

本保荐机构于2025年4月10日召开了立项会议，以记名投票方式对本项目的立项申请进行了审议。本次参会的立项委员共5名，经三分之二以上的参会表决委员表决通过，同意本项目立项。

2、项目问核程序

项目组于 2025 年 4 月 19 日向内核管理部提出问核申请，内核管理部对全套问核材料进行初审，股权债权产品管理部质量控制组于 2025 年 4 月 21 日至 25 日入驻项目现场，对项目尽职调查、质量控制情况及底稿收集、制作情况进行现场检查。2025 年 5 月 26 日，内核管理部以现场及通讯的方式组织召开了问核会议。

3、项目内核审批

内核管理部对内核全套材料进行初审，并于2025年5月4日出具了内核初审报告。项目组组织人员对内核初审报告提出的问题进行核查，并于2025年5月27日以书面形式回复内核管理部。内核管理部对项目组回复进行审核同意后，于2025年5月27日提请召开内核会议进行审核。

保荐机构于2025年5月29日召开了内核会议，以记名投票方式对本项目进行了审议。本次参会的内核委员共7名，三分之二以上参会委员投票表决结果为“内核通过”，同意推荐本项目。

（二）内核意见

保荐机构于2025年5月29日召开了内核会议对池州华宇电子科技股份有限公司本次发行进行审核。通过履行以上内核程序，保荐机构认为池州华宇电子科技股份有限公司本次发行申请符合《证券法》及中国证监会相关法规规定的发行条件，同意推荐其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

第二节 保荐机构承诺

一、保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及北京证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人的经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，同意推荐发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，并据此出具本发行保荐书。

二、保荐机构就下列事项做出承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、北交所有关向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会、北京证券交易所规定的其他事项。

第三节 对本次证券发行的推荐结论

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论

华创证券作为本次股票发行的保荐机构，本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分的尽职调查，就发行人与本次发行有关的事项严格履行了内部审核程序，并已通过华创证券内核会议的审核。华创证券对发行人本次股票发行的保荐结论如下：

发行人符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会规定的发行条件，同意推荐其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

二、发行人就本次证券发行所履行的决策程序

（一）董事会决策程序

2025年5月23日，发行人召开了第二届董事会第十一次会议，全体董事出席会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次公开发行并在北交所上市相关的议案。

（二）股东大会决策程序

2025年6月12日，发行人召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次公开发行并在北交所上市相关的议案，并同意授权董事会处理与公司本次公开发行股票并在北交所上市事宜。

三、本次证券发行符合《公司法》规定的说明

本保荐机构查阅了发行人招股说明书、本次公开发行相关董事会、股东大会决议，发行人本次拟公开发行的股票为每股面值1.00元的人民币普通股股票，每

股发行条件和价格相同，任何单位或者个人所认购的发行人每股股票所支付的对价相同，符合《公司法》第一百四十三条的规定。公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等相关议案，公司已就本次拟向不特定合格投资者公开发行股票的种类、数额、价格、发行对象等作出决议，符合《公司法》第一百五十一条的规定。

经核查，本保荐机构认为：发行人本次证券发行符合《公司法》的相关规定。

四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明

本保荐机构对发行人符合《证券法》规定的发行条件的情况进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为发行人本次发行符合《证券法》规定的发行条件，具体情况如下：

（一）发行人具备健全且运行良好的组织机构

本保荐机构查阅了发行人的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事任职及议事制度》、历次股东大会、董事会、监事会决议、会议记录及相关制度文件，实地考察了发行人各部门的经营运作，确认发行人已具有完善的公司治理结构，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会各专门委员会等制度，建立健全了内部经营管理机构和相应的内部管理制度，相关机构和人员能够依法履行职责，公司治理规范有效，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项之规定。

（二）发行人具备持续经营能力

本保荐机构查阅了会计师事务所出具的发行人最近三年的审计报告等财务资料、发行人最近三年的经营情况、发行人正在履行的重大业务合同等资料，发行人经营状况稳定、财务状况良好，报告期内实现归属于母公司所有者的净利润分别为8,596.35万元、4,202.05万元、5,667.45万元，具备持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

（三）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

本保荐机构查阅了会计师事务所出具的发行人最近三年的审计报告等财务资料，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人最近三年财务会计报告出具了无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项之规定。

（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

本保荐机构对相关政府部门进行了访谈，查阅了公安机关、检察院、法院等政府机构的网络公开信息，取得了相关政府部门出具的守法证明，确认发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项之规定。

（五）发行人符合中国证监会规定的其他条件

经核查，本保荐机构认为发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件，符合《证券法》第十二条第一款第（五）项之规定。

五、本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件的说明

本保荐机构根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》对发行人及本次发行的相关条款进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为，本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件。本保荐机构的具体核查意见如下：

（一）发行人符合《注册管理办法》第九条的规定

发行人于2024年10月23日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌，于2025年5月20日进入创新层，目前所属层级为创新层，符合《注册管理办法》第九条的规定。

（二）发行人符合《注册管理办法》第十条的规定

1、具备健全且运行良好的组织机构

发行人已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，已建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等工作制度，选举了董事会、监事会成员并在公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，制定了相应的实施细则，明确了权责和决策程序，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员均能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条第（一）项的规定。

2、具有持续经营能力，财务状况良好

本保荐机构查阅了会计师事务所出具的发行人最近三年的审计报告等财务资料，发行人报告期内营业收入分别为55,759.44万元、57,812.59万元、68,288.55万元，报告期内实现归属于母公司所有者的净利润分别为8,596.35万元、4,202.05万元、5,667.45万元，具备持续经营能力，财务状况良好，符合《注册管理办法》第十条第（二）项的规定。

3、最近三年财务会计报告无虚假记载，被出具无保留意见审计报告

本保荐机构查阅了会计师事务所出具的发行人最近三年的审计报告等财务资料，最近三年，发行人财务会计报告无虚假记载，均被出具无保留意见审计报告，符合《注册管理办法》第十条第（三）项的规定。

4、依法规范经营

本保荐机构查阅了发行人取得的工商、税务等机构出具的有关证明文件、发行人所处行业的研究报告及政策资料等文件，保荐机构认为，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十条第（四）项的规定。

（三）发行人符合《注册管理办法》第十一条的规定

本保荐机构查阅了发行人工商资料、核查主管部门就发行人出具的合规证明以及相关主体出具的调查表等资料、检索中国裁判文书网等公开网站信息等，结

合发行人律师出具的法律意见书、会计师出具的审计报告，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，最近一年内未受到中国证监会行政处罚，符合《注册管理办法》第十一条的规定。

六、本次证券发行符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的上市条件的说明

本保荐机构根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关条款对发行人及本次发行进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为，本次证券发行符合《上市规则》规定的上市条件。本保荐机构的具体核查意见如下：

（一）发行人符合《上市规则》第2.1.2条的规定

2024年10月23日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，于2025年5月20日进入创新层，目前所属层级为创新层；根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第3号》之“3-4 审核与监管程序衔接”，发行条件中“连续挂牌满12个月”指“发行人在本所上市委员会审议时已连续挂牌满12个月”。预计截至北交所上市委召开审议会议之日，发行人符合在全国股转系统连续挂牌满12个月的条件。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024年末公司归属于发行人股东的净资产为66,690.38万元，不低于5,000万元；本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过2,115万股股票（未考虑超额配售选择权的情况下），不少于100万股，发行对象不少于100人；发行人目前股本总额6,344.8097万元，公开发行后，公司股本总额不少于3,000万元；本次拟对外发行不超过2,115万股股票（未考虑超额配售选择权的情况下），公开发行后，公众股东持股比例不低于本次公开发行完成后公司股本总额的25%；公开发行后，公司股东人数不少于200人；公开发行后，满足中国证监会和北交所规定的其他条件。

因此，本保荐机构认为，发行人符合《上市规则》第2.1.2条的规定。

（二）发行人符合《上市规则》第2.1.3条第（一）项的规定

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，发行人2024年度实现归属于发行人股东的净利润（归属于发行人股东扣除非经常性损益前后净利润孰低）为5,519.43万元，不低于1,500.00万元；加权平均净资产收益率（归属于发行人股东扣除非经常性损益前后净利润孰低）为8.23%，不低于8%。公司预计向不特定合格投资者公开发行价格计算的股票市值不低于2亿元，符合《上市规则》第2.1.3条第（一）项的规定。

（三）发行人符合《上市规则》第2.1.4条的规定

本保荐机构查阅了发行人工商登记资料，与发行人主要股东、管理层访谈，获取主要股东出具声明与承诺，取得了工商、税收、环保、劳动和社会保障、住房公积金、土地、房屋等方面的主管机关出具的有关证明文件，以及查询公开信息，本保荐机构认为，最近36个月内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

本保荐机构查阅了发行人董事、监事和高级管理人员提供的个人简历及其分别出具的相关承诺，核查股东大会、董事会、监事会会议纪录，查询外部公开信息，本保荐机构认为：发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近12个月内不存在被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；或因证券市场违法违规行为受到全国股转系统、证券交易所等自律监管机构公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在公司及其控股股东、实际控制人被列入失信被执行人名单且情形尚未消除的情形。

发行人自挂牌以来，能够及时披露定期报告，不存在未按照《证券法》、中国证监会、全国股转系统的规定在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告，或者未在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制并披露半年度报告的情形。

报告期内，发行人的经营业绩稳定，最近24个月内主营业务未发生重大变化，最近24个月内实际控制人未发生变更；最近24个月内董事、高级管理人员未发生重大不利变化，满足经营稳定性的要求，不存在对发行人经营稳定性、直接面向市场独立持续经营的能力具有重大不利影响，或者存在发行人利益受到损害等其他情形。

经核查，发行人业务、资产、人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响发行人独立性或者显失公平的关联交易；发行人或其控股股东、实际控制人、占发行人主营业务收入或净利润比例超过10%的重要子公司不存在被列入失信被执行人名单且尚未消除的情形，满足直接面向市场独立持续经营的能力。同时，发行人不存在利益受到损害等其他情形。

综上，经核查，发行人符合《上市规则》第2.1.4条的规定。

七、关于廉洁从业的专项核查意见

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）等文件要求，保荐机构对本次发行过程的廉洁从业事项核查如下：

（一）关于保荐机构有偿聘请其他第三方机构或个人行为的说明

本次保荐业务中，华创证券不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。

（二）关于发行人有偿聘请其他第三方机构或个人行为的说明

在本次发行中，发行人聘请华创证券担任本项目的保荐机构及承销机构、聘请安徽天禾律师事务所担任发行人律师、聘请容诚担任审计机构和验资机构、聘请中水致远资产评估有限公司担任资产评估机构等公开发行依法需聘请的证券服务机构。

上述中介机构均为本项目依法需聘请的证券服务机构。发行人除依法聘请了证券服务机构外，还聘请了北京金证互通资本服务股份有限公司提供财经公关顾

问服务、聘请了北京时美时代图文设计有限公司提供文件排版服务。发行人已与上述中介机构签订了相关服务合同，上述中介机构依法出具了专业意见或报告。

经核查，除聘请上述服务中介机构外，发行人不存在其他直接或间接有偿聘请第三方或个人的行为。

（三）保荐机构结论性意见

经核查，本次保荐业务中，保荐机构不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的相关规定。

经核查，发行人在本项目中除上述聘请行为外，不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方或个人的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的相关规定。

八、关于发行人私募投资基金股东登记备案情况的核查意见

截至本发行保荐书签署日，发行人共有9家私募投资基金股东。保荐机构通过中国证券投资基金业协会网站进行了检索，并查阅了相关股东提供的私募投资基金备案证明以及私募投资基金管理人登记证书等资料，关于发行人现有股东中私募投资基金及其管理人备案情况如下：

基金名称	基金编号	备案时间	运作状态	基金管理人名称	登记编号	登记时间
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）	SES785	2018-11-22	正在运作	安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）	P1031235	2016-04-25
芜湖高新毅达中小企业创业投资基金(有限合伙)	SES831	2018-11-16	正在运作	安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）	P1031235	2016-04-25
深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)	SNA591	2020-10-19	正在运作	上海涌铧投资管理有限公司	P1003507	2014-06-04
苏州吴中涌宸创业投资合伙企业（有限合伙）	SQH546	2021-04-22	正在运作	上海涌铧投资管理有限	P1003507	2014-06-04

				公司		
上海涌月创业投资合伙企业（有限合伙）	SCJ085	2018-02-28	正在运作	上海涌铧投资管理有限公司	P1003507	2014-06-04
嘉兴悦时景和创业投资合伙企业（有限合伙）	SNQ609	2020-12-31	正在运作	宁波悦时私募基金管理合伙企业（有限合伙）	P1069546	2019-02-26
合肥悦时景朗股权投资合伙企业（有限合伙）	SQK829	2021-04-30	正在运作	宁波悦时私募基金管理合伙企业（有限合伙）	P1069546	2019-02-26
合肥国耀科技创新创业投资合伙企业（有限合伙）	SJQ218	2020-01-20	正在运作	合肥市创新科技风险投资有限公司	P1001957	2014-05-04
安徽安元投资基金有限公司	S81798	2015-11-13	正在运作	安徽安元投资基金管理有限公司	P1023390	2015-09-18

该等私募投资基金及其管理人均已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案、登记。除前述情形外，发行人其他股东不属于《私募暂行办法》及《私募登记和备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按照前述规定履行登记或备案程序。

九、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项的核查意见

经核查，保荐机构认为：发行人关于本次发行对即期回报的摊薄影响分析具备合理性，发行人填补即期回报的措施及董事、高级管理人员所做出相关承诺事项符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件中关于保护小投资者合法权益的精神及要求。

十、依据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并

上市业务规则适用指引第1号》，对发行人的创新发展能力进行核查

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》的“1-8 行业相关要求”，本保荐机构就发行人的创新发展能力进行了充分核查。

（一）关于发行人的创新发展能力的核查过程

1、访谈发行人董事长、关键岗位人员，了解发行人盈利模式、销售模式、生产模式、研发模式等，了解发行人的主要产品、核心技术、创新特征及先进性，了解公司所处行业的竞争格局、在行业中的市场地位、与同行业公司相比较的竞争优势等；

2、访谈研发部门负责人，了解公司的在研项目内容及目标、研发投入情况，以及专利及非专利技术在主要产品中的应用情况；

3、查看发行人的员工名册及核心技术人员简历，查阅公司研发部门的相关管理制度，了解公司研发部门的设置情况、研发流程、激励制度等；

4、查阅行业法律法规、国家政策文件、行业研究报告、同行业上市公司公开披露信息，了解发行人所处行业的市场规模及发展前景、主要技术指标、行业进入壁垒等；

5、对发行人主要客户和供应商进行访谈，了解发行人与主要客户、供应商的合作情况、上下游企业对发行人的评价，以及发行人行业市场地位、核心竞争力、产品/服务的优劣势等。

（二）关于发行人的创新发展能力的核查依据

公司是国家级专精特新“小巨人”企业、安徽省优秀民营企业、国家级高新技术企业。公司承担的安徽省科学技术厅省科技重大专项项目“基于铜基底的平面型 SIP 封装设计与应用开发”于 2019 年通过验收，相关技术成果“铜基系统级封装关键技术及产业化”于 2022 年获得安徽省人民政府颁布的科学技术进步奖三等奖。公司于 2019 年被安徽省发展和改革委员会认定为安徽省“专用芯片系统级封装工程研究中心”，于 2023 年获中共安徽省委和安徽省人民政府授予

的安徽省“专精特新”企业 50 强的荣誉。公司参与了《电子元器件 半导体器件长期贮存 第 2 部分：退化机理》、《半导体器件 第 16-2 部分：微波集成电路 预分频器》、《三维集成电路 第 1 部分：术语和定义》等行业标准的制定。

1、技术创新

公司在行业内具备一定的技术研发优势，在封装领域，公司目前已拥有多芯片组件（MCM）封装技术、三维（3D）叠芯封装技术、微型化扁平无引脚（QFN/DFN）封装技术、高密度微间距集成电路封装技术、Flip Chip 封装技术等多项核心技术。在测试服务领域，公司较早实现了高压电源管理芯片一站式全功能测试技术、指纹生物识别芯片测试技术等多项核心技术，并实现了产品的测试量产，在给客户提供关键技术测试方案上具有突出表现，为客户抢占市场先机及提升竞争力提供有力保障。公司主要核心技术均为自主开发，公司主要产品的核心技术如下：

（1）封装业务

序号	核心技术名称	技术来源	成熟度
1	多芯片组件（MCM）封装技术	自主开发	量产阶段
2	三维（3D）叠芯封装技术	自主开发	量产阶段
3	微型化扁平无引脚（QFN/DFN）封装技术	自主开发	量产阶段
4	高密度微间距集成电路封装技术	自主开发	量产阶段
5	Flip Chip 封装技术	自主开发	量产阶段

（2）测试业务

序号	核心技术名称		技术来源	成熟度
1	测试方案开发技术能力	高压电源管理芯片一站式全功能测试技术	自主开发	量产阶段
		指纹生物识别芯片测试技术		
		基于逻辑测试机的大容量非易失性串行存储器芯片测试技术		
		电容式触控类芯片测试技术		
		消防安全芯片标识码烧写和管理测试技术		
		嵌入式高端移动存储设备主控芯片测试技术		
		无人驾驶视频转换接口芯片测试技术		
		射频芯片测试技术		
		高清视频处理芯片的测试技术		

序号	核心技术名称		技术来源	成熟度
		第三代半导体芯片测试技术		
		大电流测试扩展技术		
		车规级角度位置传感器芯片自动化测试技术		
		局部互联车载网络控制芯片自动化测试技术		
		SLT 系统级自动化测试技术		
		Burn In 自动化测试技术		
		TMR 传感器自动化测试技术		
2	测试及辅助设备设计制造及优化升级技术	分选机设计制造及优化升级技术	自主开发	量产阶段
		自动装盘机设计制造及优化升级技术		
		芯片编带设备设计制造技术（Tray To Reel）		
		三温探针台升级改造技术		

2、公司建立了完善的技术持续创新机制

（1）建立健全研发体系，加大自主研发力度

IC 封装测试属于技术和资本密集型行业，技术创新是实现企业可持续发展的根本保证。公司自成立以来，不断加大研发投入，引进先进的研发设备和高端技术人才，持续建设研发中心，建立健全研发组织架构，完善研发管理制度。公司经过多年的探索和不断总结经验，现已形成了自主研发体系，建立了科学的研发组织架构和规范的研发流程；并形成了以绩效为基础，结合薪酬和职务体系的创新激励体制，为人才资源奠定了坚实的基础。

（2）高度重视人才培养，加强研发队伍建设

公司本着以人为本的经营理念，建立了完善的创新激励机制，充分调动员工的积极性，培养了一支年轻高效、严谨、充满活力、从业经验丰富的创新研发人才队伍。截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有研发技术人员 181 人，占员工总人数的 11.94%。公司研发队伍的专业结构合理，研发团队专业覆盖电子信息工程、微电子、机械设计与制造、工艺设计、软件开发、计算机科学与技术等多个行业相关专业，研发人员均具备扎实的理论知识和丰富的行业经验。

（3）完善创新激励机制，提高研发人员积极性

公司不断建立并完善项目管理、项目评审和人才培养机制，根据项目实际贡

献和进度、取得成果的大小给予项目开发人员相应的激励，提高研发人员积极性，提高研发效率，以确保公司创新能力和技术优势。

3、科技成果转化

公司在发展过程中不断加大技术创新力度，报告期内公司研发费用分别为3,324.33 万元、3,850.59 万元和 4,052.87 万元，占报告期各期营业收入的比例分别为 5.96%、6.66%和 5.93%。发行人经过多年的业务及研发积累，培养出一支经验丰富、理论扎实、贴近市场的研发团队。除通过自有研发部门进行技术研发外，还十分重视与高等院校的产学研合作，极大地提高了公司的研发能力与资源配置能力。报告期内，公司与合肥工业大学、安徽大学、安庆师范大学、合肥师范学院建立友好的合作关系。

目前，公司核心技术已全面应用于公司生产经营业务中，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已取得 40 项发明专利、153 项实用新型专利、324 项计算机软件著作权，不断推进技术成果转化及产业化应用。

（三）关于发行人的创新发展能力的核查结论

综上，保荐机构经核查认为：公司具有创新性特征，符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》1-8规定的相关要求，符合国家产业政策和北交所定位。

十一、发行人财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查

保荐机构对发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件中有关审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露是否符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 2 号》的规定进行了逐项核查，核查结果如下：

1、发行人所处行业产业政策未发生重大不利调整；

2、进出口业务未受到重大限制；

3、发行人税收政策未出现重大不利变化；

4、发行人所处行业未出现周期性变化；

5、发行人业务模式及竞争趋势未发生重大变化；

6、发行人主要采购服务的采购规模及采购价格以及发行人主要产品及服务的销售规模及销售价格未出现大幅变化；

7、发行人未出现新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项；

8、发行人主要客户或供应商未出现重大变化，重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化；

9、发行人未出现重大安全事故或其他可能影响投资者判断的重大事项。

综上所述，保荐机构认为发行人在审计截止日后的生产经营内外部环境未发生重大变化。保荐机构已督促发行人于招股说明书等文件中切实做好审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露。

第四节 发行人面临的主要风险

一、与发行人相关的风险

（一）以常规封装测试产品及中端专业测试平台为主，中高端封装测试及高端专业测试市场竞争力较弱的风险

报告期内，公司主要封装测试（含单独封装）业务收入和利润来源于 SOP、SOT、TO 等常规封测产品，主要专业测试收入和利润来源于中端专业测试平台，实现量产的中高端封测产品有 QFN/DFN、LQFP、LGA 等，高端专业测试平台实现的收入较少。

受公司在先进封装测试技术方面的研发投入和人才储备限制，公司在 FC、BGA、WLCSP、SiC/GaN 等先进封装测试领域的产品设计及生产工艺等与国内外领先企业存在较大的技术差距，公司的产品结构、产品应用领域、市场占有率也因此受限，公司在先进封装测试产品市场的竞争力相对较弱。

据 Yole 相关预测，2023 年全球封测产业规模达 857 亿美元，预计 2024 年可增至 899 亿美元，同比增长 5%，全球先进封装在 2023 年的市场规模达到 378 亿美元，预计到 2029 年该市场规模将超过 695 亿美元，2023-2029 年期间的复合年增长率约 11%。由于 AI、新能源汽车和 AI PC 等各种大趋势，先进封装在整个封测市场中所占份额将持续增加比重从 2022 年的 46%提升至 2028 年的 53%。随着半导体行业进入后摩尔时代对先进封装测试的依赖也逐渐增加，如果未来公司无法开发出满足市场需求的先进封装测试形式产品，将导致公司产品结构扩充受限、核心竞争力下降，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

（二）业绩及毛利率下滑风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 28.56%、22.29%、21.18%，其中封装测试（含单独封装）业务毛利率分别为 21.98%、12.91%、10.84%，专业测试毛利率分别为 42.52%、40.02%、39.14%。总的来看，报告期内公司主营业务毛利率呈下降趋势。

2024 年以来，随着消费电子等终端应用领域的回暖，公司业务订单快速增

长，封装测试产能利用率回升明显，专业测试产能利用率基本企稳。若未来公司销售订单增速放缓甚至下滑导致公司产能利用率下降，同时公司产品销售价格不能企稳回升甚至进一步下滑，将导致公司主营业务毛利率进一步下滑，相应的公司将面临经营业绩下滑的风险。

（三）原材料价格波动风险

公司主要原材料包括引线框架、塑封树脂、键合丝（金丝、铜线、合金线等）和装片胶。报告期内，公司主营业务成本中直接材料占比分别为 31.75%、28.19%、27.48%，占比较高，原材料价格的波动会对公司的毛利率产生较大影响。公司原材料如引线框架、装片胶、部分键合丝供给价格受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响存在一定程度的波动，若未来公司原材料价格上涨，而公司产品售价不能及时调整，则原材料价格上涨将对公司的盈利能力造成不利影响。

（四）生产用工短缺及人力成本上升风险

集成电路封装测试行业属于人才密集型和劳动密集型企业，尤其是对熟练的一线生产工人需求量较大。报告期内，公司业务规模快速扩张，生产用工人数亦随之快速增长，截至各报告期末公司员工人数分别为 1,073 人、1,347 人、1,516 人。

充足稳定的劳动力供应是公司扩大生产经营规模的必备条件，但随着中国逐步步入老龄化社会，劳动人口的数量呈现负增长和劳动力短缺的趋势，相应地导致了生产用工短缺，加速推动了人力成本的上升。此外，公司主要经营地之一的安徽省池州市虽然具备一定的集成电路产业基础，但对生产人员特别是具备一定技术的熟练技术工人缺乏足够的吸引力。公司未来如果不能保持或及时招聘到足够的技术工人或者人力成本大幅上升，将会对公司的生产效率和经营规模的扩大产生不利影响。

（五）进口设备依赖的风险

报告期内，公司因市场需求增长、行业供应链本土化趋势加速等因素进行了产能扩张，固定资产投资规模呈现快速增长趋势。截至 2024 年 12 月末，公司固定资产中机器设备原值为 119,865.95 万元。公司现有机器设备以进口设备为主，

主要供应商包括东京精密、DISCO、KS、ASM 等国际知名设备厂商。公司进口设备主要应用于晶圆减薄、切割、键合等生产工序，对于公司的生产经营至关重要。

截至本发行保荐书签署日，公司现有进口设备及募集资金投资项目所需进口设备尚未受到管制。若未来国际贸易形势变化，半导体生产设备及其生产技术受到管制，如公司现有进口设备出现使用受限的情形，将对公司生产经营造成较大不利影响。

（六）应收账款回收风险

公司报告期各期末应收账款净额分别为 9,891.06 万元、12,499.93 万元、10,421.09 万元，占当期流动资产的比例分别为 30.81%、37.19%、28.55%，占比较高。公司通过了一系列的制度、措施用于加强应收账款的回收管理，报告期内，公司账龄 1 年以内应收账款占应收账款余额的比例均在 95%以上。未来随着公司募投项目的达产以及业务规模的扩大，应收账款的金额可能会进一步增加，如果未来公司重要客户出现信用风险而导致大额应收账款无法按期收回或者无法收回的情形，将对公司业绩造成重大不利影响。

（七）存货跌价风险

尽管公司的生产模式主要根据客户订单的要求，按照客户提供的产品规格、质量要求和供货时间组织生产，为了应对主要原材料价格波动，同时考虑原材料交付周期因素，公司通常会根据市场行情预测订单需求情况备用一定的安全库存。公司报告期各期末存货净额分别为 6,786.36 万元、5,221.06 万元、7,130.24 万元，占当期流动资产的比例分别为 21.14%、15.53%、19.53%，存货占流动资产的比例较高。报告期各期末，公司计提存货跌价准备余额分别为 308.61 万元、340.02 万元、663.44 万元。若市场环境发生重大变化导致出现主要原材料价格大幅波动、下游客户存在重大延期或违约等情形，公司将承担存货跌价的风险。

（八）税收优惠政策变化风险

报告期内，公司享受的税收优惠主要为高新技术企业所得税税率优惠和研发费用加计扣除所得税优惠。公司 2018 年被认定为高新技术企业，2021 年、2024

年通过了高新技术企业资格复审，报告期内享受企业所得税税率为15%的税收优惠。

全资子公司华力宇2020年被认定为高新技术企业，2023年通过了高新技术企业资格复审，报告期内享受企业所得税税率为15%的税收优惠。

全资子公司无锡华宇光微2021年被认定为高新技术企业，2024年通过了高新技术企业资格复审，报告期内享受企业所得税税率为15%的税收优惠。

全资子公司合肥华宇2023年被认定为高新技术企业，2023年、2024年享受企业所得税税率为15%的税收优惠。

根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号文，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。根据《财政部、税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第11号）、《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年39号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策执行期限延长至2022年12月31日。子公司无锡华宇光微、华力宇符合上述规定的条件，2022年1月1日至2022年12月31日可享受上述可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额的优惠政策。

根据《财政部、税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财政部 税务总局公告2023年第17号）的规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额。公司、子公司无锡华宇光微、华力宇、合肥华宇符合上述规定的条件。

根据财政部、税务总局、科技部公告2022年第28号文，高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。凡在2022年第四季度内具有高新技术企业资格的企业，均可适用该项政策。企业选择适用该项政策当年不足扣除的，可结转至以后年度按现行有关规定执行。公司及子公司华力宇、无锡华宇光微符合上述规定的条件。

子公司合肥华达 2022 年、2023 年符合小型微利企业税收政策。子公司合肥华宇 2022 年符合小型微利企业税收政策。子公司华宇福保报告期内均符合小型微利企业税收政策。

报告期内，公司享受的研发费用加计扣除、高新技术企业所得税、高新技术企业购进固定资产加计扣除税收优惠及小型微利企业税收优惠及增值税加计抵减税收优惠合计金额为 2,434.37 万元、993.72 万元和 1,985.81 万元，占剔除股份支付影响后的当期利润总额的比例分别为 23.93%、21.10%和 33.15%。报告期内，公司享受的税收优惠政策在一定程度上提升了公司经营业绩，若未来国家税收政策发生变化，或者公司及子公司未能持续获得高新技术企业认定，将对公司的经营业绩造成不利影响。

（九）政府补助变化风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助分别为 2,489.57 万元、714.75 万元和 1,077.39 万元，占剔除股份支付影响后的当期利润总额的比例分别为 24.47%、15.18%和 17.99%。若未来公司不能获得政府补助或者获得的政府补助大幅减少，会对公司的经营业绩造成不利影响。

（十）募集资金投资项目新增产能消化风险

本次募集资金将用于大容量存储器与射频模块封测数字化改造项目、合肥集成电路测试产业基地晶圆测试及芯片成品测试项目及补充流动资金（含偿还银行借款）。大容量存储器与射频模块封测数字化改造项目达产后将新增封装测试产能 8.58 亿只/年，其中 QFN 新增封装测试产能 6.00 亿只，LQFP 新增封装测试产能 1.80 亿只，WBBGA 新增封装测试产能 0.40 亿只，FCBGA 新增封装测试产能 0.20 亿只，LGA 新增封装测试产能 0.18 亿只；合肥集成电路测试产业基地晶圆测试及芯片成品测试项目达产后将新增晶圆测试产能 91.20 万片/年，芯片成品测试产能 24 亿只/年。

虽然公司已经通过充分的市场调研和可行性论证，但新增产能的消化需要依托公司未来的产品竞争力、市场开拓能力、集成电路封测市场发展情况以及下游终端市场的环境等，具有一定的不确定性。在未来募投项目实施过程中，若市场环境、竞争对手策略、公司市场开拓等方面出现重大不利变化，或市场增长情况

不及预期，或行业整体产能扩张规模过大导致竞争加剧，则将会对公司募投项目的产能消化产生不利影响。

（十一）资产折旧增加的风险

随着本次募投项目的建成投产，公司固定资产规模相应增加，资产折旧金额也随之加大。根据募集资金使用计划，本次募集资金投资项目建成达产后产生的新增年折旧费用为 3,669.37 万元，对公司业绩影响较大。若募集资金投资项目不能按照计划达产并实现经济效益，将在一定程度上影响公司净利润和净资产收益率水平。

（十二）研发失败的风险

随着半导体行业进入后摩尔时代，半导体行业正越来越重视封装测试技术的发展，行业技术升级速度的加快要求企业必须加大研发投入。企业需要根据不断变化的市场需求，持续地投入大量的资金和人员对现有产品进行升级并持续开发新产品。如果未来公司在研发立项时未能充分论证或判断有误，在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者研发出的产品未能得到市场认可，公司将面临研发项目失败的风险，产品创新不能满足市场需求或符合行业发展方向导致客户流失、业绩下滑，而前期的研发投入难以收回将对公司经营业绩产生不利影响。

（十三）研发技术人员紧缺及流失的风险

公司所处的集成电路封测行业属于技术、人才密集型行业，技术研发人员是公司研发活动和技术创新的基础，是保持技术优势的核心因素。随着集成电路封装测试行业规模的快速增长和市场竞争的不断加剧，企业对人才的竞争将愈加激烈。如果公司不能提供有竞争力的薪酬待遇、设立具备较强吸引力的激励考核机制，公司将难以稳定核心技术团队以及引进优秀研发技术人员，公司将可能面临研发技术人员流失及紧缺的风险，将对公司的持续研发能力造成不利影响，进而影响公司的业绩表现。

（十四）环保风险

集成电路封装过程涉及到多种化学工艺，会产生以废水、废气为主的污染物，

尤其是电镀环节产生的工业废水中包含易溶于水的有害物质，重金属含量高，需要企业配备专业污水处理措施。环保问题已经越来越受到我国政府的重视，不排除今后由于环保标准提高导致公司环保投入增加的可能。此外，若在生产过程中因管理疏忽、不可抗力等因素以致出现环境事故，可能会对环境造成一定的破坏和不良后果。若出现环保方面的意外事件对环境造成污染或者触犯环保方面法律法规，则会对公司的声誉及日常经营造成不利影响。

（十五）核心技术失密风险

经过公司研发团队多年的努力和积累，公司拥有了多项核心技术。目前，公司与核心技术人员均签订了《劳动合同》并约定了保密和竞业禁止条款，核心研发成果也申请了专利保护。但是公司目前还有多项核心技术尚处于研发过程中，如果出现核心研发技术人员离职或者离职后没有遵守约定的保密和竞业禁止义务的情形，公司将面临核心技术失密的风险。

（十六）规模扩张带来的经营管理风险

报告期内，公司资产总额分别为 111,896.22 万元、141,855.45 万元和 172,749.85 万元，营业收入分别为 55,759.44 万元、57,812.59 万元和 68,288.55 万元，资产规模和营收规模都增长迅速。公司通过多年的持续发展，已建立起与公司业务相匹配的经营管理体系。本次公开发行股票后，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、业务规模、员工数量将进一步扩充，对于公司的内控体系、生产管理、财务管理等方面均提出了更高的要求。如果公司不能及时调整、完善组织结构和管理体系以适应公司规模的快速扩张，将对公司的生产经营带来不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）技术及产品升级迭代风险

公司所处的集成电路封装测试行业具有封装测试技术多样、技术及产品更新速度快的特点，尤其是近年来随着云计算、物联网、大数据等新业态的出现并快速发展，集成电路应用终端呈现小型化、智能化的发展趋势，我国集成电路的技术水平、产品结构等也紧跟终端系统产品的趋势，推动了集成电路封装测试技术

向大功率、高密度、高频率、高可靠性、高能效和小型化、薄型化的方向演变。

日月光、安靠、长电科技、华天科技、通富微电等领先企业均已较全面的掌握较多种类先进封装技术，而公司产品目前仍以 SOP、SOT、TO 等常规封装形式为主，中高端封装产品仅有 QFN/DFN、LQFP、LGA、FCLGA、BGA、FCBGA 等。虽然未来相当长的时间内，集成电路传统封装与先进封装将同时存在且两者之间不存在必然的替代关系；但在集成电路封装领域技术快速发展的背景下，公司常规封装形式产品仍面临技术升级迭代风险。如果公司不能对封测产品的应用领域和终端市场进行准确的判断，快速识别并响应客户需求的变化，在新产品、新技术研发方面无法保持持续投入并推出具有竞争力的新产品，封装技术与工艺不能跟上竞争对手新技术、新工艺的持续升级换代或者下游客户的需求，公司可能因无法开拓新的产品和业务而导致客户流失、市场占有率降低，逐渐丧失市场竞争力从而对公司的生产经营造成重大不利影响。

（二）行业需求波动风险

集成电路封装测试行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性，其波动幅度甚至会超过宏观经济波动幅度。同时，近年来国内集成电路行业受国际贸易形势以及市场需求变化等因素的影响，产能紧缺，国内市场需求扩大，推动了国内集成电路需求的高速增长。

如果未来宏观经济波动较大，或者国际政治经济环境变化，集成电路行业供需关系出现波动，相应的国内半导体行业的景气度也将随之受到影响而产生较大波动；或公司主要客户受国际贸易形势变化影响，经营业务不及预期，其向公司下达的业务订单可能减少。如国内半导体行业景气度下滑或公司主要客户因国际贸易形势变化影响经营业务不及预期等情形出现，公司经营业务增速将可能放缓甚至出现下滑，进而导致公司经营业绩出现波动。

（三）市场竞争加剧风险

随着下游终端市场的快速增长和行业供应链本土化趋势的加速，国内集成电路封装测试需求持续稳定增长，同时国家也加大了对半导体行业的政策扶持力度，近年来社会各界对集成电路封装测试行业的资金和资源投入也不断增加，行

业潜在或新进入者数量也在增加，使得市场竞争愈发激烈。如果公司未来不能在产品研发、工艺改进、产品质量、市场开拓等方面提升自身优势和竞争力，将可能导致公司因市场竞争加剧导致市场占有率下降，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

（四）收入季节性风险

报告期内，公司一季度主营业务收入占全年主营业务收入的比例分别为24.27%、20.65%、21.39%，相对较低，公司主营业务收入存在一定的季节性波动。公司封装测试产品主要用于智能家居、消费类电子、工业控制等领域，每年的第四季度和次年的第一季度属于该等终端产品的需求旺季，但由于次年的第一季度节假日较长，公司客户会选择提前在第四季度备货，导致一季度的销售量相对较少。因此，受下游终端客户的需求影响，公司销售收入存在季节性波动的风险。

三、其他风险

（一）实际控制人不当控制风险

本次发行前，彭勇、高莲花、赵勇、高新华分别持有公司 34.03%、25.81%、13.40%和 3.99%的股份，彭勇、赵勇和高新华通过华宇芯管理间接持有公司 0.13%股份；彭勇担任华宇芯管理的普通合伙人，通过华宇芯管理间接控制公司 3.37%的股份，彭勇、高莲花、赵勇、高新华签署了《一致行动人协议》，为公司的共同控股股东和实际控制人，合计控制公司 80.60%的股份。同时彭勇担任公司董事长、总经理，高莲花担任公司董事，赵勇、高新华担任公司董事、副总经理。本次发行完成后，彭勇、高莲花、赵勇、高新华仍将控制本公司 60.45%的股份（假设公司公开发行新股 2,115 万股），彭勇、高莲花、赵勇、高新华仍将为公司实际控制人，处于绝对控股地位。未来如果上述共同实际控制人不能很好的约束自身行为，利用其控制地位对公司的重大事项予以不当控制或者施加不当影响，将可能损害公司及其他股东的利益，也不利于公司的持续发展。

（二）股价波动风险

股票二级市场价格不仅受公司财务状况、经营业绩和发展前景的影响，而且

受股票供需关系、国家宏观经济状况、国家政策、投资者的心理预期以及其他多种因素的影响，也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动，因此公司存在股价下跌的风险。

（三）发行失败风险

公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票，发行结果除将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况的影响外，还会由于投资者对行业和公司的理解存在偏差以及受投资偏好的影响，使得投资者对公司股票发行价格及股价的未来趋势认知不一样。如果公司的价值和发展前景不能得到投资者认可而导致后续发行环节出现发行认购不足，则会导致公司面临发行失败的风险。

第五节 发行人的发展前景评价

一、发行人所处行业市场前景

（一）行业发展现状

1、集成电路行业市场

（1）全球集成电路市场

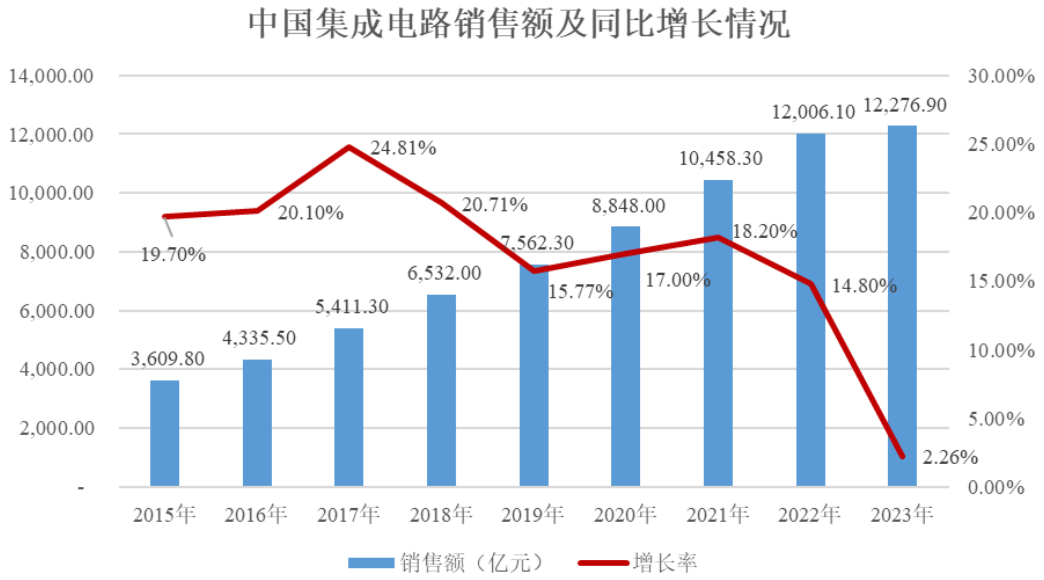
2023 年，在全球经济增速放缓、电子产品消费低迷的背景下，全球半导体市场进入负增长区间，行业周期逐步探底后初现回暖迹象。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2023 年全球半导体市场规模从 2022 年创历史新高的 5,741 亿美元下降 8.2%，至 5,268.9 亿美元；总销售量达 9,109.9 亿颗，同比下降 16.9%；2023 年平均销售价格(ASP)为 0.58 美元，较 2022 年上涨 10.5%。

从集成电路产业链分布变化来看，早期的集成电路企业大多为垂直整合型 IDM 模式，即企业内部可完成设计、制造、封装和测试等所有集成电路生产环节，但这种模式下的企业普遍具有资产投入重、资金需求量大、变通不畅等缺点。20 世纪 90 年代，随着全球化进程加快和集成电路制程难度的不断提高等原因，集成电路产业链开始向专业化的分工方向发展，逐渐形成了独立的半导体设计企业、晶圆制造企业和封装测试企业。自 21 世纪以来，受先进制程研发费用大幅提升、制程更新迭代速度加快以及大规模晶圆厂和封装厂投资总额大幅提高等因素的影响，众多 IDM 厂商纷纷缩减了晶圆产线和封装厂的投入。目前，集成电路设计、晶圆制造和封装测试各自独立且垂直分工的产业模式，已成为集成电路产业链中最普遍的经营模式。

（2）中国集成电路市场

从市场规模来看，相比全球市场而言，我国的集成电路产业起步较晚，但在国家政策的大力支持下，发展速度明显快于全球水平。根据中国半导体行业协会的统计，中国集成电路行业 2021 年销售额为 10,458.30 亿元，同比增长 18.20%；2022 年销售额持续增长，达到 12,006.10 亿元，同比增长 14.80%。2023 年由于

受到宏观环境影响增速有所下滑，但仍保持增长趋势。2015 年至 2023 年，中国集成电路产业销售额增长迅速，年均复合增长率约为 16.53%，持续保持增速全球领先的势头。



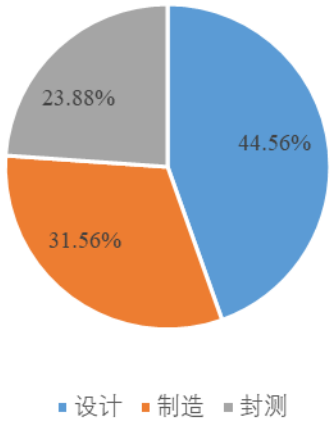
数据来源：《中国半导体产业发展状况报告（2024 年版）》

在国家政策扶持以及市场应用带动下，中国集成电路产业保持快速增长，生产总量规模实现较大突破，根据国家统计局的数据，国内集成电路行业总生产量从 2015 年的 1,087.20 亿块上升到 2021 年的 3,594.30 亿块，年均复合增长率约为 22.05%。2022 年，主要受宏观经济环境变化的影响，国内集成电路行业总生产量为 3,241.90 亿块，较 2021 年度略有下滑。2023 年国内集成电路行业总生产量为 3,514.00 亿块，较 2022 年度增长 8.39%。总体而言，中国的芯片生产量在不断提高。

数据来源：《中国半导体产业发展状况报告（2024 年版）》

从产业链分工情况来看，根据中国半导体协会统计数据，2023 年我国集成电路产业销售中，设计环节作为高附加值环节，其销售额占比从 2018 年的 38.57%攀升至 2023 年的 44.56%，是产业链中销售额最大的环节；制造环节销售额占比 31.56%；封测环节销售额占比 23.88%。设计、制造和封测三个环节大约呈 4：3：3 的比例，产业结构的均衡有利于集成电路行业专业化分工趋势的延续，芯片设计产业的快速发展，也能同时推动封装测试行业的加速发展。

2023年中国集成电路销售额构成



数据来源：《中国半导体产业发展状况报告（2024 年版）》

2、封装测试市场

（1）全球封装测试市场

随着整个半导体产业的技术进步、市场发展、人力成本、政府政策扶持等因素的作用，全球集成电路封测产业聚集中心已从起源地美、欧、日等地区逐渐分散到中国台湾、中国大陆、新加坡和马来西亚等亚太地区。

根据中国半导体行业协会信息显示，2023 年全球封测市场规模为 822 亿美元，同比增长 0.86%。未来，全球半导体封装测试技术将继续向小型化、集成化、低功耗方向发展，在新兴市场和半导体技术进步的共同带动下，附加值更高的先进封装将得到越来越多的应用，封装测试业市场有望持续向好预计 2026 年市场规模有望达 961 亿美元。

数据来源：《中国半导体产业发展状况报告（2024 年版）》

根据《中国半导体产业发展状况报告（2024 年版）》显示，2023 年全球前十大封装测试企业合计营收达到 300.4 亿美元，亚太地区依然是全球集成电路封装测试业的主力军，全球前十大封装测试企业中，中国台湾地区有五家，中国大陆有三家，美国、新加坡各一家。

2023 年全球前十大集成电路封装测试企业

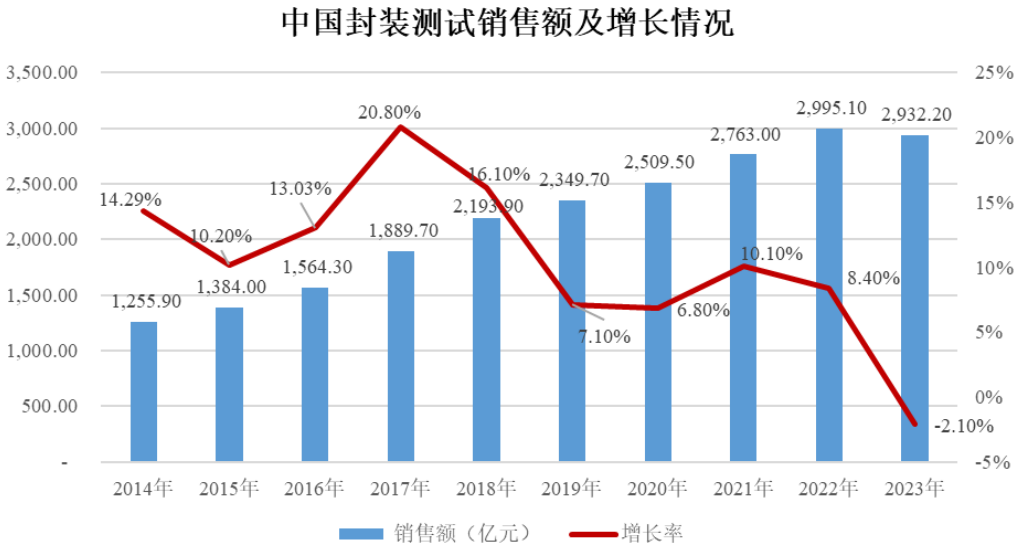
排名	公司	销售额（亿美元）	总部所在地
1	日月光控股	94.5	中国台湾
2	安靠科技	65	美国
3	长电科技	38.9	中国大陆
4	通富微电	32.4	中国大陆
5	力成科技	20.7	中国台湾
6	华天科技	17.1	中国大陆
7	京元电子	10.6	中国台湾
8	UTAC 集团	8	新加坡
9	南茂科技	6.8	中国台湾
10	颀邦科技	6.4	中国台湾

数据来源：《中国半导体产业发展状况报告（2024 年版）》

（2）中国封装测试市场

我国集成电路封装测试是整个半导体产业中发展较为成熟的板块，在规模和技术能力方面与世界先进水平较为接近。近年来，我国集成电路封装测试业销售额逐年增长，从 2014 年的 1,255.90 亿元增至 2023 年的 2,932.20 亿元，年复合增长率 9.88%。受宏观经济环境变化及芯片产能紧缺等多重因素的影响，我国封装测试行业仍然保持着较快速增长，随着居家办公场景的普遍，以及汽车自动化、网联化等领域的兴起，封装测试能力供不应求。

从集成电路产业链结构来看，在 2023 年中国集成电路产业销售额中封装测试占比 23.88%；芯片设计与制造业占比分别为 44.56%和 31.56%，整体产业结构趋于完善。随着高附加值的芯片设计和芯片制造业的加快发展，也推进了集成电路封装测试行业的发展。



数据来源：《中国半导体产业发展状况报告（2024 年版）》

相对于芯片设计和晶圆制造产业来说，中国封装测试领域的技术水平和销售规模不落后国际知名企业的水平，以长电科技、通富微电和华天科技为典型代表，作为国内封装测试行业的龙头企业，已稳居全球封装测试企业前十强。

全球半导体产业经历二次产业转移，目前处于第三次产业转移的进程之中，作为半导体领域壁垒相对较低的领域，封测产业目前主要转移至亚洲区域，主要包括中国大陆、中国台湾、东南亚等。

我国集成电路封测行业属于市场化程度较高的行业，衡量行业竞争力的关键指标通常包括技术创新能力、生产效率、产品质量、市场占有率、客户服务能力和供应链整合能力等。

我国集成电路封测行业是中国大陆集成电路发展较为完善的板块，技术能力与国际先进水平比较接近，我国封测市场已形成内资企业为主的竞争格局。从企业综合实力来看，大致可以将国内封装测试厂商进行如下划分，具体如下表所示：

国内集成电路封装测试企业类别

类型	主要特征	主要优势	代表厂商
行业内规模或技术具有领先优势的企业	规模大、综合实力强、引领行业技术和产品创新，高效、严格的品质管理体系；外资企业以 BGA、CSP、WLCSP、FC、MEMS、Bumping、TSV 等为主，内资企	技术、市场和资金优势	长电科技、华天科技、通富微电及安靠科技、日月光等在国内设立的封装测试企业

类型	主要特征	主要优势	代表厂商
	业在先进封装产品市场已占有一定比例		
具备一定规模、具备较强技术实力的中等规模企业	规模中等、具备较强的技术实力和完整的品质管控体系，专注于技术应用和工艺创新，以 SOT、SOP、QFP、QFN/DFN、LQFP 等系列产品为主，逐步向 CSP、FC、TSV、SIP 等先进产品延伸	拥有较强的研发和技术能力，具有完善的生产与质量管理体系；产品性价比高、竞争力强	以华宇电子、气派科技等为代表的中等规模企业
规模较小的企业	规模较小、技术或生产管理能力一般，主要以 TO、DIP、SOP 等产品为主	无明显优势	数量众多的中小型企业

在经过 2021 年市场行情高涨的一年后，2022 年至 2023 年，受宏观经济环境变化、行业周期波动等因素影响，集成电路行业整体增速放缓。企业能否积极应对市场变化、有效扩充产品终端应用领域，是企业经营业绩能否持续增长的关键。近期，长电科技、华天科技、通富微电等领先企业均已将主要投资的重点放在汽车电子专业封测基地、Chiplet 等先进封装、新一代功率器件封装产能规划等项目上，减少现有工厂常规产品的技术和产能更新的规模。短期来看，大量资金投入先进研发项目可能会对公司盈利造成一定负担。但长期来看，更丰富的产品结构、更广泛的终端应用领域是维持企业营收规模的关键要素。因此，未来集成电路封装测试企业重心将倾向于中高端产品的研发投入，形成产品结构偏向中高端、大力拓宽产品应用领域的竞争格局。

（二）行业面临的机遇

1、国家政策高度重视及大力支持

集成电路产业是现代信息产业的基础和核心产业之一。近年来，为加快推进我国集成电路及封装测试产业发展，国务院、财政部、税务总局、发改委、工信部等国家及各级政府部门推出了一系列法规和产业政策。另外，国家设立产业投资基金，主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级，支持设立地方性集成电路产业投资基金，鼓励社会各类风险投资和股权投资基金进入集成电路领域。财税政策优惠方面，国家各部门陆续推出《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》、《关

于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》、《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》等重要政策。

行业内主要法律法规、发展规划、产业政策的发布和落实，为集成电路产业的发展提供了良好的制度和政策保障，同时在财政、税收、技术和人才等多方面提供了有力支持，为公司创造了良好的经营环境，对公司的经营发展带来积极影响。

2、封装测试业向中国大陆转移

半导体行业因具有下游应用广泛、生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资高、风险大等特点，叠加下游应用市场的不断兴起，半导体产业链从集成化到垂直化分工越来越明确，并经历了两次空间上的产业转移分别为垂直整合模式和 IDM 模式，目前正向第三次空间产业转移即专业分工模式，形成设计、制造、封测三大环节。加之国家对半导体行业的大力支持以及人才、技术、资本的产业环境不断成熟，全球半导体产业酝酿第三次产业转移，即向中国大陆转移趋势逐渐显现。由于人力成本的优势，集成电路封测业已经向中国大陆转移。

3、下游市场新需求不断涌现

集成电路行业的发展主要取决于下游的终端应用领域。近年来，随着物联网、智能家居、汽车电子、5G 通信等新兴领域的快速扩张，芯片的需求量将大幅度提升，为半导体封装测试行业提供了更大的市场空间。

4、行业供应链本土化趋势带来巨大发展机遇

近年来各类国际事件引发了社会各界对工业缺“芯”少“魂”的国民大讨论，使得我国认识到了集成电路行业自主可控的重要性，进一步推动了我国集成电路行业供应链本土化的进程。接踵而至的国际事件使得业界认识到国内集成电路企业技术研发水平直接关系到我国集成电路水平的提升和国家信息安全，尽快实现集成电路行业自主可控具有重要性和紧迫性，极大加快了集成电路行业供应链本土化的进程。

在我国政府部门的大力政策支持、产业基金设立和半导体企业自身技术水平持续进步的大环境下，集成电路行业供应链本土化趋势开始加速。此外，国内设

计公司的能力不断增强和国内晶圆制造多条产线投产，为我国集成电路封装测试产业发展提供了广阔空间。

二、发行人的核心竞争优势

（一）技术创新优势

公司在行业内具备一定的技术研发优势，在封装领域，公司目前已拥有多芯片组件（MCM）封装技术、三维（3D）叠芯封装技术、微型化扁平无引脚（QFN/DFN）封装技术、高密度微间距集成电路封装技术、Flip Chip 封装技术等多项核心技术。在测试服务领域，公司较早实现了高压电源管理芯片一站式全功能测试技术、指纹生物识别芯片测试技术等多项核心技术，并实现了产品的测试量产，在给客户提供关键技术测试方案上具有突出表现，为客户抢占市场先机及提升竞争力提供有力保障。

公司是国家级专精特新“小巨人”企业、安徽省优秀民营企业、国家级高新技术企业。公司承担的安徽省科学技术厅省科技重大专项项目“基于铜基底的平面型 SIP 封装设计与应用开发”的相关技术成果“铜基系统级封装关键技术及产业化”于 2022 年获得安徽省人民政府颁布的科学技术进步奖三等奖。公司于 2019 年被安徽省发展和改革委员会认定为安徽省“专用芯片系统级封装工程研究中心”，于 2023 年获中共安徽省委和安徽省人民政府授予的安徽省“专精特新”企业 50 强的荣誉。

为了保障公司具备长期的市场竞争力，公司高度重视技术人才的引进和技术工艺的持续创新。未来，公司将进一步提升现有核心业务的技术水平，开发出更具竞争力的封装测试产品，巩固和扩大自身的竞争优势。

（二）设备自主研发优势

公司在导入 QFN/DFN 产品研发过程中，为了解决装盘机设备供应问题，研发中心整合过往设备技术及再创新，成功开发了属于自己的国产装盘机。该机器较于业界国外品牌设备具有成本优势和交期短等优势，目前已经为公司快速扩产做出了重大贡献。公司设备开发团队掌握了半导体测试相关设备的先进技术，从机械设计、电气控制系统设计、设备软体程式设计与模拟、设备优化改造设计等

一应俱全。尤其是测试站的部分测试分选机、测试编带机等由公司自主独立开发与制造，为适应多样化产品提升设备能力与品质稳定提供了保障。

（三）一站式服务优势

公司主营业务包括集成电路封装测试、晶圆测试、芯片成品测试，业务链条包含晶圆测试、芯片封装及成品测试全流程，公司具备较强的分选机、编带机等设备的设计制造及升级改造能力，封装测试所需的载带、料管、胶盘等主要包装材料绝大部分由公司自行加工生产，既实现了对客户需求的快速响应，还有效降低了封装测试业务成本，提升了经营效率和效果。公司封装测试产品终端应用可覆盖消费电子、计算机及数据处理、汽车电子、工业和物联网等行业应用领域，可以满足各类客户的一站式需求，有效支撑客户的高效产品解决方案，提高客户对公司的粘性。

公司建立了完善的子公司内部沟通、分享、联动制度，集团内公司的客户只要存在封装测试需求，公司均可提供对应服务，既节省了客户的运输与时间成本，也利于公司完善服务价值链，增加服务总体附加值。公司通过对生产工艺的集约化、精细化管理全面降低生产成本，完善的管理体系严格监控每一生产步骤，保障集成电路封装测试的可靠性、稳定性和一致性处于行业领先水平。

（四）地域优势

公司总部地处安徽省池州市经济技术开发区，长三角中心区 27 城之一。公司所在区域离九华山机场仅有 17 公里，该区域交通便捷，适合发展集成电路封测产业。此外，公司在深圳、无锡和合肥设有子公司。

从区域分布来看，长三角地区和珠三角地区是我国集成电路产业集中度最高、产业链最完整、制造水平最高的区域，长三角地区的集成电路产业具有较为显著的范围经济效益，接壤并立足长三角和珠三角地区有利于半导体企业更贴近客户和原辅材料供应商，减少运输成本、提高客户服务响应效率、缩短供应链周期。

同时，公司生产经营场地分布在池州、深圳、无锡、合肥等地，各区域工厂可以互相调配产能以保证产品交期，保证了客户供应链的及时、安全，有效地提

高了客户满意度，增强了公司的行业竞争力。

（五）客户资源优势

公司深耕集成电路封装测试行业多年，凭借稳定的封测良率、可靠的产品质量、不断提升的量产能力、良好的服务意识等，公司获得了众多客户的认可，公司客户遍布华南、华东、华北、西北、西南、中国台湾等多个区域，以及韩国、美国等不同国家。报告期内，公司也多次获得集创北方、中科蓝讯、炬芯科技、ABOV、英集芯、普冉股份等客户授予的“优秀供应商”、“最佳合作伙伴”、“优秀服务团队”、“最佳配合工程团队”等荣誉奖项。此外，公司针对客户的需求设计的专用配件也得到了费恩格尔等客户的好评。

三、募集资金投资符合行业发展方向及发行人发展目标

本次募集资金投资项目实施后，公司业务经营规模将随之进一步扩大，形成更明显的规模优势，服务效率和品质将得到进一步提升，利润总额及净利润水平也将明显增加，提升公司的盈利水平和核心竞争力。

长期来看，募集资金投资项目的建设完成将有利于实现公司的战略目标，增强公司的核心竞争力，使公司在未来的市场竞争中获得更大的竞争优势，巩固并提升公司的行业地位。

第六节 结 论

经核查，保荐机构认为，池州华宇电子科技股份公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》和《上市规则》等有关法律法规的要求；因此，本保荐机构同意保荐池州华宇电子科技股份有限公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。

附件：保荐代表人专项授权书

（以下无正文）

（此页无正文，为《华创证券有限责任公司关于池州华宇电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之发行保荐书》之签署页）

项目协办人：

危唯

保荐代表人：

孙翊斌　　黄永圣千

保荐业务部门负责人：

杨锦雄

内核负责人：

高瑾妮

保荐业务负责人：

杨锦雄

总经理：

陈　强

法定代表人、董事长：

陶永泽

华创证券有限责任公司

2025年6月22日

华创证券有限责任公司保荐代表人专项授权书

根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及其他有关法律、法规和证券监督管理规定，华创证券有限责任公司（以下简称“本公司”）现授权孙翊斌、黄永圣千担任池州华宇电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐代表人，具体负责该公司发行上市的尽职推荐及持续督导等保荐工作。

截至本授权书出具日：

一、两名保荐代表人孙翊斌、黄永圣千最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条的规定。

二、孙翊斌、黄永圣千最近三年内未担任过已完成项目的签字保荐代表人。

三、孙翊斌、黄永圣千无作为签字保荐代表人申报的在审项目。

本公司法定代表人陶永泽和本项目签字保荐代表人孙翊斌、黄永圣千承诺上述情况真实、准确、完整，并承担相应的责任。

特此授权。

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司保荐代表人专项授权书》之签章页）

保荐代表人签字：

孙翊斌　　黄永圣千

法定代表人或授权代表签字：

陶永泽

华创证券有限责任公司

2025 年 6 月 22 日